

香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该内容而引致的任何损失承担任何责任。



HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

华虹半导体有限公司

(于香港注册成立之有限公司)

(股份代号：01347)

新闻稿

二零二三年第四季度业绩公布

所有货币以美元列帐，除非特别指明。

本合并财务报告系依香港财务报告准则编制。

中国香港 — 2024年2月6日 — 全球领先的特色工艺纯晶圆代工厂华虹半导体有限公司（香港联交所股票代码：01347；上交所科创板证券代码：688347）（“本公司”）于今日公布截至二零二三年十二月三十一日止三个月的综合经营业绩。

二零二三年第四季度主要财务指标（未经审核）

- 销售收入 4.554 亿美元，上年同期为 6.301 亿美元，上季度为 5.685 亿美元。
- 毛利率 4.0%，上年同期为 38.2%，上季度为 16.1%。
- 母公司拥有人应占溢利 3,540 万美元，上年同期为 1.591 亿美元，上季度为 1,390 万美元。
- 基本每股盈利 0.021 美元，上年同期为 0.122 美元，上季度为 0.009 美元。
- 净资产收益率（年化）2.4%，上年同期为 22.0%，上季度为 1.2%。

二零二四年第一季度指引

- 我们预计销售收入约在 4.5 亿美元至 5.0 亿美元之间。
- 我们预计毛利率约在 3%至 6%之间。

总裁致辞

公司总裁兼执行董事唐均君先生对二零二三年第四季度以及全年业绩评论道：

“华虹半导体二零二三年第四季度销售收入为 **4.554** 亿美元，单季毛利率为 **4.0%**，达到指引。二零二三年全年实现销售收入 **22.861** 亿美元，全年毛利率为 **21.3%**。”

“**2023** 年市场形势低迷，对全球半导体产业来说是极富挑战的一年。但随着产业链去库存的持续，以及新一代通信、物联网等技术的快速渗透，近期半导体市场已出现提振信号，公司与之相关的图像传感器、电源管理等产品均在第四季度有较好的表现。为了进一步满足中长期市场需求，公司加快产能扩充速度，坚持多元化特色工艺平台技术研发，以提高产品供应能力和市场响应速度。截至二零二三年第四季度末，公司折合八英寸月产能增加到了 **39.1** 万片。同时，公司的第二条十二英寸生产线建设也在按计划推进中，预计将于年底前建成投产。”

唐总继续讲道：“华虹半导体始终坚持技术创新，在研发方面投入了大量资源，积极推进新工艺平台的研发和现有工艺平台的优化和提升。此外，公司还积极与国内外上下游企业建立战略合作，加强产业链整合，积极开拓新兴市场。在新的一年里，公司将继续为客户提供更优质的技术和服务，聚焦汽车、光伏、消费产品升级等新成长市场，实现可持续发展，巩固特色工艺晶圆代工领域的领先地位！”

电话会议公告

- 日期 2024 年 2 月 6 日（星期二）
- 时间: 17:00 香港/上海时间
04:00 美国东部时间
- 发言人: 唐均君，总裁兼执行董事
王鼎，执行副总裁兼首席财务官
- 广播: 会议将在 http://www.huahonggrace.com/c/investor_webcast.php 或 <https://edge.media-server.com/mmc/p/wehhuicp> 作线上直播
(请提前注册登记)
- 电话直拨: 请在会议前使用以下链接先进行注册。注册后，您将收到确认邮件获得拨入号码及 PIN（个人身份识别码）。
<https://register.vevent.com/register/BI252a25170c124349b8452f07232bd0ad>
重要提示: 在会议开始前，您需要使用确认邮件中提供的 PIN（个人身份识别码）才能进入会议。请在注册后，注意查收并保存确认邮件。出于安全原因，请不要与任何人共享您的 PIN（个人身份识别码）。
- 网上回放: 直播约 2 小时后，您可于 12 个月内在以下网页重复收听会议。
http://www.huahonggrace.com/c/investor_webcast.php

关于华虹半导体

华虹半导体有限公司（A 股简称：华虹公司，688347；港股简称：华虹半导体，01347）（“本公司”）是全球领先的特色工艺纯晶圆代工企业，秉持“8 英寸 + 12 英寸”、先进“特色 IC + Power Discrete”的发展战略，为客户提供多元化的晶圆代工及配套服务。本公司专注于嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理和逻辑与射频等“8 英寸 + 12 英寸”特色工艺技术的持续创新，有力支持新能源汽车、绿色能源、物联网等新兴领域应用，其卓越的质量管理体系亦满足汽车电子芯片生产的严苛要求。本公司是华虹集团的一员，而华虹集团是中国拥有“8 英寸 + 12 英寸”先进集成电路制造主流工艺技术的产业集团。

本公司在上海金桥和张江建有三座 8 英寸晶圆厂，月产能约 18 万片。另在无锡高新技术产业开发区内建有一座月产能 9.45 万片的 12 英寸晶圆厂（“华虹无锡”），这不仅是全球领先的 12 英寸特色工艺生产线，也是全球第一条 12 英寸功率器件代工生产线。目前，本公司正在推进华虹无锡二期 12 英寸芯片生产线（“华虹制造”）的建设。

如欲取得更多公司相关资料，请浏览：www.huahonggrace.com。

经营业绩概要
(以千美元计, 每股盈利和营运数据除外)

	二零二三年 第四季度 (未经审核)	二零二二年 第四季度 (未经审核)	二零二三年 第三季度 (未经审核)	同比	环比
销售收入	455,361	630,110	568,529	(27.7)%	(19.9)%
毛利	18,220	240,707	91,623	(92.4)%	(80.1)%
毛利率	4.0%	38.2 %	16.1%	(34.2)	(12.1)
经营开支	(95,063)	(59,579)	(85,065)	59.6 %	11.8 %
其他收入/(损失)净额	87,600	35,565	(19,417)	146.3%	(551.2)%
税前溢利/(损失)	10,757	216,693	(12,859)	(95.0)%	(183.7)%
所得税开支	(7,210)	(30,918)	(12,999)	(76.7)%	(44.5)%
期内溢利/(损失)	3,547	185,775	(25,858)	(98.1)%	(113.7)%
净利润率	0.8 %	29.5 %	(4.5)%	(28.7)	5.3
以下各方应占利润:					
母公司拥有人	35,386	159,136	13,890	(77.8)%	154.8 %
非控股权益	(31,839)	26,639	(39,748)	(219.5)%	(19.9)%
持有人应占每股盈利					
基本	0.021	0.122	0.009	(82.8)%	133.3 %
摊薄	0.021	0.121	0.009	(82.6)%	133.3 %
付运晶圆(折合 8 吋千片)	951	992	1,077	(4.1)%	(11.7)%
产能利用率 ¹	84.1 %	103.2 %	86.8 %	(19.1)	(2.7)
净资产收益率 ²	2.4 %	22.0 %	1.2 %	(19.6)	1.2

二零二三年第四季度

- 销售收入 4.554 亿美元, 上年同期为 6.301 亿美元, 上季度为 5.685 亿美元, 主要由于平均销售价格及付运晶圆下降。
- 毛利率 4.0%, 上年同期为 38.2%, 上季度为 16.1%, 主要由于平均销售价格下降及产能利用率降低。
- 经营开支 9,510 万美元, 同比上升 59.6%, 主要由于研发活动的政府补助减少及工程片开支增加, 环比上升 11.8%, 主要由于华虹制造人员开支增加。
- 其他收入净额 8,760 万美元, 同比上升 146.3%, 主要由于政府补贴增加, 相比上季度为其他损失净额 1,940 万美元, 主要由于政府补贴增加, 以及本季度为外币汇兑收益上季度为外币汇兑损失。
- 所得税开支 720 万美元, 同比下降 76.7%, 环比下降 44.5%, 主要由于应课税利润下降。
- 期内溢利 350 万美元, 上年同期为 1.858 亿美元, 上季度为期内损失 2,590 万美元。
- 母公司拥有人应占溢利 3,540 万美元, 上年同期为 1.591 亿美元, 上季度为 1,390 万美元。
- 基本每股盈利 0.021 美元, 上年同期为 0.122 美元, 上季度为 0.009 美元。
- 净资产收益率(年化) 2.4%, 上年同期为 22.0%, 上季度为 1.2%。

¹产能利用率按平均月约当产量除以总估计月产能计算。

²母公司拥有人应占利润 / 加权平均母公司拥有人应占净资产。

经营业绩概要
(以千美元计, 每股盈利和营运数据除外)

	2023 (未经审核)	2022 (已审核)	同比
销售收入	2,286,113	2,475,488	(7.7)%
毛利	487,096	843,656	(42.3)%
毛利率	21.3%	34.1%	(12.8)
经营开支	(333,057)	(279,130)	19.3%
其他收入/(损失)净额	19,540	(68,456)	(128.5)%
税前溢利	173,579	496,070	(65.0)%
所得税开支	(47,154)	(89,499)	(47.3)%
年内溢利	126,425	406,571	(68.9)%
净利润率	5.5%	16.4%	(10.9)
以下各方应占利润:			
母公司拥有人	280,034	449,912	(37.8)%
非控股权益	(153,609)	(43,341)	254.4%
持有人应占每股盈利			
基本	0.189	0.345	(45.2)%
摊薄	0.188	0.342	(45.0)%
付运晶圆(折合 8 吋千片)	4,103	4,088	0.4%
产能利用率	94.3%	107.4%	(13.1)
净资产收益率	6.3%	15.2%	(8.9)

二零二三年度

- 销售收入 22.861 亿美元, 较上年度下降 7.7%, 主要由于平均销售价格下降。
- 毛利率 21.3%, 较上年度下降 12.8 个百分点, 主要由于平均销售价格下降及折旧成本上升, 部分被人员开支下降所抵消。
- 经营开支 3.331 亿美元, 较上年度上升 19.3%, 主要由于研发活动的政府补助减少及研发工程片开支上升。
- 其他收入净额 1,950 万美元, 上年度为其他损失净额 6,850 万美元, 主要由于外币汇兑损失减少, 政府补贴及利息收入增加, 部分被财务费用上升所抵消。
- 年内溢利 1.264 亿美元, 上年度为 4.066 亿美元。
- 母公司拥有人应占溢利 2.800 亿美元, 上年度为 4.499 亿美元。
- 基本每股盈利 0.189 美元, 上年度为 0.345 美元。
- 净资产收益率 6.3%, 上年度为 15.2%。

销售收入分析

按类别划分的 销售收入	二零二三年 第四季度 千美元 (未经审核)	二零二三年 第四季度 % (未经审核)	二零二二年 第四季度 千美元 (未经审核)	二零二二年 第四季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
晶圆	436,375	95.8 %	602,591	95.6 %	(166,216)	(27.6)%
其他	18,986	4.2 %	27,519	4.4 %	(8,533)	(31.0)%
销售收入总额	455,361	100.0 %	630,110	100.0 %	(174,749)	(27.7)%

- 本季度 95.8%的销售收入来源于半导体晶圆的直接销售。

销售收入分析

按晶圆尺寸划分的 销售收入	二零二三年 第四季度 千美元 (未经审核)	二零二三年 第四季度 % (未经审核)	二零二二年 第四季度 千美元 (未经审核)	二零二二年 第四季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
8 吋晶圆	250,743	55.1 %	397,513	63.1 %	(146,770)	(36.9)%
12 吋晶圆	204,618	44.9 %	232,597	36.9 %	(27,979)	(12.0)%
销售收入总额	455,361	100.0 %	630,110	100.0 %	(174,749)	(27.7)%

- 本季度来自于 8 吋晶圆和 12 吋晶圆的销售收入分别为 2.507 亿美元及 2.046 亿美元。

销售收入分析

按地域划分的 销售收入	二零二三年 第四季度 千美元 (未经审核)	二零二三年 第四季度 % (未经审核)	二零二二年 第四季度 千美元 (未经审核)	二零二二年 第四季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
中国 ³	366,508	80.5 %	456,876	72.6 %	(90,368)	(19.8)%
北美 ⁴	36,811	8.1 %	85,956	13.6 %	(49,145)	(57.2)%
亚洲 ⁵	30,176	6.6 %	42,055	6.7 %	(11,879)	(28.2)%
欧洲	18,475	4.1 %	33,690	5.3 %	(15,215)	(45.2)%
日本 ⁶	3,391	0.7 %	11,533	1.8 %	(8,142)	(70.6)%
销售收入总额	455,361	100.0 %	630,110	100.0 %	(174,749)	(27.7)%

- 本季度来自于中国的销售收入 3.665 亿美元，占销售收入总额的 80.5%，同比下降 19.8%，主要由于 MCU、智能卡芯片、超级结和 NOR flash 产品需求减少，部分被 IGBT 及 CIS 产品需求增加所抵消。
- 本季度来自于北美的销售收入 3,680 万美元，同比下降 57.2%，主要由于 MCU 及其他电源管理产品的需求减少。
- 本季度来自于亚洲的销售收入 3,020 万美元，同比下降 28.2%，主要由于 MCU 产品的需求减少。
- 本季度来自于欧洲的销售收入 1,850 万美元，同比下降 45.2%，主要由于智能卡芯片的需求减少。
- 本季度来自于日本的销售收入 340 万美元，同比下降 70.6%，主要由于 MCU 产品的需求减少。

³包括中国大陆及中国香港。

⁴包括于 2020 年由一家总部位于欧洲的公司所收购的一家主要美国客户。

⁵不包括中国及日本。

⁶包括于 2013 年由一家总部位于美国的公司所收购的一家主要日本客户。

销售收入分析

按技术平台划分的 销售收入	二零二三年 第四季度 千美元 (未经审核)	二零二三年 第四季度 % (未经审核)	二零二二年 第四季度 千美元 (未经审核)	二零二二年 第四季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
嵌入式非易失性存储器	112,026	24.6 %	236,281	37.5 %	(124,255)	(52.6)%
独立式非易失性存储器	14,753	3.2 %	36,557	5.8 %	(21,804)	(59.6)%
分立器件	182,377	40.2 %	212,972	33.8 %	(30,595)	(14.4)%
逻辑及射频	56,227	12.3 %	42,942	6.8 %	13,285	30.9 %
模拟与电源管理	89,448	19.6 %	100,940	16.0 %	(11,492)	(11.4)%
其他	530	0.1 %	418	0.1 %	112	26.8 %
销售收入总额	455,361	100.0 %	630,110	100.0 %	(174,749)	(27.7)%

- 本季度嵌入式非易失性存储器销售收入 1.120 亿美元，同比下降 52.6%，主要由于 MCU 及智能卡芯片的需求减少。
- 本季度独立式非易失性存储器销售收入 1,480 万美元，同比下降 59.6%，主要由于 NOR flash 产品的需求减少。
- 本季度分立器件销售收入 1.824 亿美元，同比下降 14.4%，主要由于通用 MOSFET 及超级结产品的需求减少，部分被 IGBT 产品需求增加所抵消。
- 本季度逻辑及射频销售收入 5,620 万美元，同比增长 30.9%，主要得益于 CIS 产品的需求增加。
- 本季度模拟与电源管理销售收入 8,940 万美元，同比下降 11.4%，主要由于其他电源管理及模拟产品的需求减少。

销售收入分析

按工艺技术节点划分的销售收入	二零二三年 第四季度 千美元 (未经审核)	二零二三年 第四季度 % (未经审核)	二零二二年 第四季度 千美元 (未经审核)	二零二二年 第四季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
55nm 及 65nm	60,920	13.4 %	59,244	9.4 %	1,676	2.8 %
90nm 及 95nm	82,552	18.1 %	124,450	19.8 %	(41,898)	(33.7)%
0.11 μ m 及 0.13 μ m	73,762	16.2 %	126,128	20.0 %	(52,366)	(41.5)%
0.15 μ m 及 0.18 μ m	31,049	6.8 %	56,227	8.9 %	(25,178)	(44.8)%
0.25 μ m	5,357	1.2 %	4,153	0.7 %	1,204	29.0 %
0.35 μ m 及以上	201,721	44.3 %	259,908	41.2 %	(58,187)	(22.4)%
销售收入总额	455,361	100.0 %	630,110	100.0 %	(174,749)	(27.7)%

- 本季度 55nm 及 65nm 工艺技术节点的销售收入 6,090 万美元，同比增长 2.8%，主要得益于 CIS 及模拟产品的需求增加，大部分被 NOR flash 及 MCU 产品的需求减少所抵消。
- 本季度 90nm 及 95nm 工艺技术节点的销售收入 8,260 万美元，同比下降 33.7%，主要由于智能卡芯片及 MCU 产品的需求减少。
- 本季度 0.11 μ m 及 0.13 μ m 工艺技术节点的销售收入 7,380 万美元，同比下降 41.5%，主要由于 MCU 产品的需求减少。
- 本季度 0.15 μ m 及 0.18 μ m 工艺技术节点的销售收入 3,100 万美元，同比下降 44.8%，主要由于 MCU 及逻辑产品的需求减少。
- 本季度 0.25 μ m 工艺技术节点的销售收入 540 万美元，同比增长 29.0%，主要得益于射频产品的需求增加。
- 本季度 0.35 μ m 及以上工艺技术节点的销售收入 2.017 亿美元，同比下降 22.4%，主要由于超级结、通用 MOSFET 及其他电源管理产品的需求减少。

销售收入分析

按终端市场分布划分的销售收入	二零二三年	二零二三年	二零二二年	二零二二年	同比	同比
	第四季度	第四季度	第四季度	第四季度		
	千美元	%	千美元	%	千美元	%
	(未经审核)	(未经审核)	(未经审核)	(未经审核)		
电子消费品	252,508	55.4 %	390,993	62.1 %	(138,485)	(35.4)%
工业及汽车	138,628	30.4 %	169,571	26.9 %	(30,943)	(18.2)%
通讯	53,973	11.9 %	50,632	8.0 %	3,341	6.6 %
计算器	10,252	2.3 %	18,914	3.0 %	(8,662)	(45.8)%
销售收入总额	455,361	100.0 %	630,110	100.0 %	(174,749)	(27.7)%

- 本季度电子消费品作为我们的第一大终端市场，贡献销售收入 2.525 亿美元，占销售收入总额的 55.4%，同比下降 35.4%，主要由于 MCU、超级结、NOR flash、智能卡芯片、及通用 MOSFET 产品的需求减少。
- 本季度工业及汽车产品销售收入 1.386 亿美元，同比下降 18.2%，主要由于 MCU、智能卡芯片、及通用 MOSFET 产品的需求减少，部分被 IGBT 产品需求增加所抵消。
- 本季度通讯产品销售收入 5,400 万美元，同比增长 6.6%，主要得益于 CIS 及模拟产品需求增加，部分被智能卡芯片需求减少所抵消。
- 本季度计算器产品销售收入 1,030 万美元，同比下降 45.8%，主要由于通用 MOSFET 及 MCU 产品需求减少。

产能⁷及产能利用率

晶圆厂(折合 8 吋千片晶圆)	二零二三年	二零二二年	二零二三年
	第四季度	第四季度	第三季度
	(未经审核)	(未经审核)	(未经审核)
产能 (200mm)	178	178	178
产能 (300mm)	95	65	80
合计产能	391	324	358
产能利用率 (200mm)	91.0%	105.9%	95.3%
产能利用率 (300mm)	77.5%	99.9%	78.4%
总体产能利用率	84.1%	103.2%	86.8%

- 本季度末月产能 391,000 片 8 吋等值晶圆。总体产能利用率为 84.1%。

⁷ 期末月产能，且为比较目的，以 30 天作为计算基础。

付运晶圆

折合 8 吋千片晶圆	二零二三年 第四季度 (未经审核)	二零二二年 第四季度 (未经审核)	二零二三年 第三季度 (未经审核)	同比	环比
付运晶圆	951	992	1,077	(4.1)%	(11.7)%

■ 本季度付运晶圆 951,000 片，同比下降 4.1%，环比下降 11.7%。

经营开支分析

以千美元计	二零二三年 第四季度 (未经审核)	二零二二年 第四季度 (未经审核)	二零二三年 第三季度 (未经审核)	同比	环比
销售及分销费用	2,684	2,914	2,415	(7.9)%	11.1 %
管理费用 ⁸	92,379	56,665	82,650	63.0 %	11.8 %
经营开支	95,063	59,579	85,065	59.6 %	11.8 %

■ 经营开支 9,510 万美元，同比上升 59.6%，主要由于研发活动的政府补助减少及工程片开支增加，环比上升 11.8%，主要由于华虹制造人员开支增加。

其他收入/(损失)净额

以千美元计	二零二三年 第四季度 (未经审核)	二零二二年 第四季度 (未经审核)	二零二三年 第三季度 (未经审核)	同比	环比
租金收入	3,447	3,352	3,428	2.8 %	0.6 %
利息收入	20,182	10,775	15,742	87.3 %	28.2 %
汇兑收益/(损失)	27,041	22,054	(13,986)	22.6 %	(293.3)%
分占联营公司溢利/(损失)	7,136	7,311	(1,410)	(2.4)%	(606.1)%
财务费用	(19,540)	(8,465)	(24,257)	130.8 %	(19.4)%
政府补贴	51,387	678	77	7,479.2 %	66,636.4 %
其他	(2,053)	(140)	989	1,366.4 %	(307.6)%
其他收入/(损失)净额	87,600	35,565	(19,417)	146.3 %	(551.2)%

■ 其他收入净额 8,760 万美元，同比上升 146.3%，主要由于政府补贴增加，相比上季度为其他损失净额 1,940 万美元，主要由于政府补贴增加，以及本季度为外币汇兑收益上季度为外币汇兑损失。

⁸管理费用包括确认为研发开支抵减项目的政府补助。

现金使用分析

以千美元计	二零二三年 第四季度 (未经审核)	二零二二年 第四季度 (未经审核)	二零二三年 第三季度 (未经审核)	同比	环比
经营活动所得现金流量净额	196,546	184,413	152,091	6.6 %	29.2 %
投资活动所用现金流量净额	(301,916)	(303,135)	(177,466)	(0.4)%	70.1 %
融资活动所得现金流量净额	642,297	120,141	3,176,383	434.6 %	(79.8)%
外汇汇率变动影响净额	58,753	23,118	(12,464)	154.1 %	(571.4)%
现金及现金等价物变动影响净额	595,680	24,537	3,138,544	2,327.7 %	(81.0)%

- 本季度经营活动所得现金流量净额 1.965 亿美元，同比上升 6.6%，环比上升 29.2%，主要由于政府补助增加及人员开支减少。
- 投资活动所用现金流量净额 3.019 亿美元，其中包括固定资产及无形资产投资支出 3.314 亿美元，部分被收到利息收入 1,780 万美元及收到政府对设备的补助 1,170 万美元所抵消。
- 融资活动所得现金流量净额 6.423 亿美元，其中非控股权益资本注资 4.917 亿美元，提取银行借款 2.466 亿美元，收到政府对财务费用的补助 300 万美元，员工行权发行股份收到 140 万美元，部分被偿还银行借款 5,490 万美元，支付利息 4,520 万美元，及支付租赁负债 30 万美元所抵消。

资本结构

以千美元计	于十二月三十一日 二零二三年 (未经审核)	于九月三十日 二零二三年 (未经审核)
资产总额	10,943,420	9,974,339
负债总额	2,928,876	2,642,094
所有者权益总额	8,014,544	7,332,245
资产负债率 ⁹	26.8%	26.5%

资本开支

以千美元计	二零二三年 第四季度 (未经审核)	二零二三年 第三季度 (未经审核)
华虹 8 吋	28,761	22,795
华虹无锡	121,918	111,827
华虹制造	180,690	59,030
合计	331,369	193,652

- 本季度资本开支 3.314 亿美元，其中 1.219 亿美元用于华虹无锡，1.807 亿美元用于华虹制造，及 2,880 万美元用于华虹 8 吋。

⁹资产负债率=负债总额/资产总额。

流动性分析

以千美元计	于十二月三十一日 二零二三年 (未经审核)	于九月三十日 二零二三年 (未经审核)
发展中物业	178,828	157,230
存货	449,749	492,783
贸易应收款项及应收票据	278,669	318,787
预付款项、其他应收款项及其他资产	33,821	34,168
应收关联方款项	11,219	19,572
已冻结存款及定期存款	32,088	31,654
现金及现金等价物	5,585,181	4,989,501
流动资产总额	6,569,555	6,043,695
贸易应付款项	235,410	213,530
其他应付款项及暂估费用	428,512	357,181
计息银行借款	193,035	180,238
租赁负债	3,076	3,281
政府补助	35,017	34,321
应付关联方款项	13,876	4,604
应付所得税	61,495	57,885
流动负债总额	970,421	851,040
净营运资金	5,599,134	5,192,655
速动比率	6.1x	6.3x
流动比率	6.8x	7.1x
贸易应收款项及应收票据周转天数	60	50
存货周转天数	97	99

- 存货由上季度末的 4.928 亿美元下降至本季度末的 4.498 亿美元，主要由于原材料及产成品的减少。
- 贸易应收款项及应收票据由上季度末的 3.188 亿美元下降至本季度末的 2.787 亿美元，主要由于销售收入下降。
- 现金及现金等价物由上季度末的 49.895 亿美元上升至本季度末的 55.852 亿美元，主要由于前述现金流量分析中阐述的原因。
- 其他应付款项及暂估费用由上季度末的 3.572 亿美元上升至本季度末的 4.285 亿美元，主要由于应付资本开支款增加。
- 净营运资金 本季度末 55.991 亿美元，流动比率 6.8。
- 贸易应收款项及应收票据周转天数 60 天。
- 存货周转天数 97 天。

上述公布详情请参阅华虹半导体网站 www.huahonggrace.com。

华虹半导体有限公司
 简明损益表(以千美元计,每股盈利和股数除外)

	截至以下日期止三个月		
	于十二月三十一日 二零二三年 (未经审核)	于十二月三十一日 二零二二年 (未经审核)	于九月三十日 二零二三年 (未经审核)
销售收入	455,361	630,110	568,529
销售成本	(437,141)	(389,403)	(476,906)
毛利	18,220	240,707	91,623
其他收入及收益	100,442	37,090	20,290
投资物业的公平值收益	103	394	-
销售及分销费用	(2,684)	(2,914)	(2,415)
管理费用	(92,379)	(56,665)	(82,650)
其他费用	(541)	(765)	(14,040)
财务费用	(19,540)	(8,465)	(24,257)
分占联营公司溢利/(损失)	7,136	7,311	(1,410)
税前溢利/(损失)	10,757	216,693	(12,859)
所得税开支	(7,210)	(30,918)	(12,999)
期内溢利/(损失)	3,547	185,775	(25,858)
以下各方应占利润			
母公司拥有人	35,386	159,136	13,890
非控股权益	(31,839)	26,639	(39,748)
持有人应占每股盈利			
基本	0.021	0.122	0.009
摊薄	0.021	0.121	0.009
用于计算持有人应占每股基本盈利的 期内已发行普通股加权平均数	1,716,439,808	1,306,626,546	1,580,159,540
用于计算持有人应占每股摊薄盈利的 期内已发行普通股加权平均数	1,720,215,394	1,314,496,496	1,587,083,357

华虹半导体有限公司
 简明损益表(以千美元计,每股盈利和股数除外)

	二零二三年 (未经审核)	二零二二年 (已审核)
销售收入	2,286,113	2,475,488
销售成本	(1,799,017)	(1,631,832)
毛利	487,096	843,656
其他收入及收益	144,370	70,986
投资物业的公平值收益	103	78
销售及分销费用	(10,189)	(12,464)
管理费用	(322,868)	(266,666)
其他费用	(33,666)	(111,360)
财务费用	(100,497)	(40,331)
分占联营公司溢利	9,230	12,171
税前溢利	173,579	496,070
所得税开支	(47,154)	(89,499)
年内溢利	126,425	406,571
以下各方应占利润		
母公司拥有人	280,034	449,912
非控股权益	(153,609)	(43,341)
持有人应占每股盈利		
基本	0.189	0.345
摊薄	0.188	0.342
用于计算持有人应占每股基本盈利的年内已发行普通股加权平均数	1,477,978,482	1,303,399,389
用于计算持有人应占每股摊薄盈利的年内已发行普通股加权平均数	1,486,531,954	1,313,945,277

华虹半导体有限公司
简明综合财务状况表(以千美元计)

	截至		
	于十二月三十一日 二零二三年 (未经审核)	于九月三十日 二零二三年 (未经审核)	于十二月三十一日 二零二二年 (已审核)
资产			
非流动资产			
物业、厂房及设备	3,519,292	3,322,946	3,367,716
投资物业	166,643	164,287	169,363
使用权资产	78,545	79,070	78,425
无形资产	49,827	29,182	32,986
于联营公司的投资	139,099	128,833	130,721
以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具	270,506	153,024	178,632
长期预付款项	149,953	36,085	7,742
递延税项资产	-	17,217	14,066
非流动资产总额	4,373,865	3,930,644	3,979,651
流动资产			
发展中物业	178,828	157,230	134,723
存货	449,749	492,783	578,060
贸易应收款项及应收票据	278,669	318,787	291,856
预付款项、其他应收款项及其他资产	33,821	34,168	48,273
应收关联方款项	11,219	19,572	13,006
已冻结存款及定期存款	32,088	31,654	1,042
现金及现金等价物	5,585,181	4,989,501	2,008,765
流动资产总额	6,569,555	6,043,695	3,075,725
流动负债			
贸易应付款项	235,410	213,530	236,999
其他应付款项及暂估费用	428,512	357,181	593,971
计息银行借款	193,035	180,238	426,756
租赁负债	3,076	3,281	4,704
政府补助	35,017	34,321	37,714
应付关联方款项	13,876	4,604	6,096
应付所得税	61,495	57,885	76,176
流动负债总额	970,421	851,040	1,382,416
流动资产净额	5,599,134	5,192,655	1,693,309
总资产减流动负债	9,972,999	9,123,299	5,672,960
非流动负债			
计息银行借款	1,906,526	1,745,779	1,481,580
租赁负债	19,129	18,650	14,644
递延税项负债	30,834	26,625	41,268
雇员福利负债	1,966	-	-
非流动负债总额	1,958,455	1,791,054	1,537,492
净资产	8,014,544	7,332,245	4,135,468
权益和负债权益			
股本	4,933,559	4,932,673	1,994,462
储备	1,367,436	1,164,151	1,036,008
本公司拥有人应占权益	6,300,995	6,096,824	3,030,470
非控股权益	1,713,549	1,235,421	1,104,998
权益总额	8,014,544	7,332,245	4,135,468

华虹半导体有限公司
简明综合现金流量表(以千美元计)

	截至以下日期止三个月		
	于十二月三十一日 二零二三年 (未经审核)	于十二月三十一日 二零二二年 (未经审核)	于九月三十日 二零二三年 (未经审核)
经营活动所得现金流量:			
税前溢利/(亏损)	10,757	216,693	(12,859)
折旧及摊销	129,135	107,849	127,305
应占联营公司(溢利)/亏损	(7,136)	(7,311)	1,410
营运资金的变动及其它	63,790	(132,818)	36,235
经营活动所得现金流量净额	196,546	184,413	152,091
投资活动所用现金流量:			
购买物业、厂房、设备及无形资产项目	(331,369)	(331,065)	(193,652)
投资联营公司	-	(4,013)	-
收到政府对物业、厂房及设备的补助	11,692	24,655	-
其他投资活动所得现金流量	17,761	7,288	16,186
投资活动所用现金流量净额	(301,916)	(303,135)	(177,466)
融资活动所得现金流量:			
非控股权益资本注资	491,723	-	-
提取银行贷款	246,620	181,470	347,707
偿还银行贷款	(54,942)	(39,826)	(239,086)
已付利息	(45,234)	(31,861)	(3,803)
支付租赁负债	(274)	(782)	(1,230)
发行股份所得收益	1,407	1,631	2,937,689
受限制货币资金减少	-	-	136,524
其他融资活动所得/(用)现金流量	2,997	9,509	(1,418)
融资活动所得现金流量净额	642,297	120,141	3,176,383
现金及现金等价物增加净额	536,927	1,419	3,151,008
外汇汇率变动影响净额	58,753	23,118	(12,464)
期初现金及现金等价物	4,989,501	1,984,228	1,850,957
期末现金及现金等价物	5,585,181	2,008,765	4,989,501

华虹半导体有限公司
简明综合现金流量表(以千美元计)

	二零二三年 (未经审核)	二零二二年 (已审核)
经营活动所得现金流量:		
税前溢利	173,579	496,070
折旧及摊销	500,439	456,860
应占联营公司溢利	(9,230)	(12,171)
营运资金的变动及其它	(23,093)	(189,894)
经营活动所得现金流量净额	641,695	750,865
投资活动所用现金流量:		
购买物业、厂房、设备及无形资产项目	(906,607)	(996,182)
投资联营公司	-	(6,717)
收到政府对物业、厂房及设备的补助	11,692	38,414
其他投资活动所得现金流量	61,603	34,329
投资活动所用现金流量净额	(833,312)	(930,156)
融资活动所得现金流量:		
发行股份所得收益	2,941,945	6,248
非控股权益资本注资	787,920	392,000
提取银行贷款	615,415	514,622
偿还银行贷款	(422,120)	(199,670)
已付利息	(106,570)	(47,286)
受限制货币资金增加	(31,214)	-
支付租赁负债	(4,597)	(3,246)
其他融资活动所得现金流量	967	9,509
融资活动所得现金流量净额	3,781,746	672,177
现金及现金等价物增加净额	3,590,129	492,886
外汇汇率变动影响净额	(13,713)	(94,261)
期初现金及现金等价物	2,008,765	1,610,140
期末现金及现金等价物	5,585,181	2,008,765

于本公告日期，本公司董事分别为：

执行董事

张素心(董事长)

唐均君(总裁)

非执行董事

孙国栋

叶峻

周利民

独立非执行董事

张祖同

王桂坝太平绅士

叶龙蜚

承董事会命

华虹半导体有限公司

张素心

董事长兼执行董事

中国 香港

二零二四年二月六日